












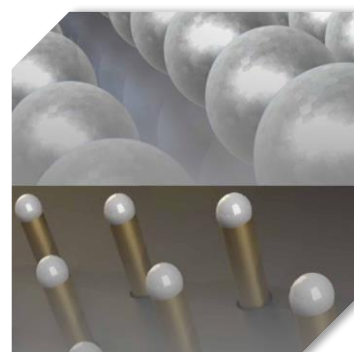
Alliages disponibles¹

Alliage	Point de fusion (°C)		PCB	Ceramic	RoHS
	Solidus	Liquidus			
Sn95Sb5	235	240	+		
Sn96.5Ag3.5	221	Eutectique	+	+	
Sn96.5Ag3 Cu0.5	217	220	+		
Sn95.5Ag3.8Cu0.7	217	Eutectique	+	+	
SnAg2.5Cu0.5	206	218		+	
Sn99Ag0.3Cu0.7	217	227	+		
Sn98.5Ag0.8Cu0.7	217	224	+		
Sn99CuSP	227	Eutectique	+		
Sn43Bi57	139	Eutectique	+		
Sn42Bi57,6Ag0,4	139	Eutectique	+	+	
Sn42Bi57Ag1	139	Eutectique	+	+	
Sn62Pb36Ag2	179	Eutectique	+	+	
Sn63Pb37	183	Eutectique	+		
Pb92,5Sn5Ag2,5	296	301	+	+	
Sn18Pb32Bi50	98	Eutectique	+		

¹Autre alliage sur demande

Taille de Particules disponibles

	Type de poudre	Taille de poudre	Pas entre connecteurs (mm)	Diam. Point de dépose
II		45-75µ	0.65	0.80 (mm)
III		25-45µ	0.50	0.50 (mm)
IV		20-38µ	0.30	0.30 (mm)
V		15-25µ	0.20	0.25 (mm)
VI		5-15µ	0.10	0.10 (mm)



CRÈMES À BRASER AVEC PLOMB

Flux	Sans Nettoyage			Nettoyage à l'eau	
	F381	D377	F917	F10	F541
Nom					
Application(s)	Sérigraphie	Sérigraphie / Dispensing	Dispensing	Sérigraphie	Sérigraphie / Dispensing
Propriété					
Sans halogènes		(+)			
Refusion sous azote (N ²)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Refusion sous air	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Refusion phase vapeur		(+)			(+)
Classification J-STD-004	M1	L0	L0	L0	H1
Résidus très clairs	(++)	(++)	(+)	(++)	N/A
Alliage Anti-Tombstone	(+)		(+)		



CONDITIONNEMENT

Seringues

Cartouches

Pots

CRÈMES À BRASER SANS PLOMB

Flux	Sans Nettoyage				Nettoyage à l'eau		
	F640	F645	F620	F169	SOP91121	WL449	F541
Nom							
Application(s)	Sérigraphie / Dispensing	Sérigraphie / Dispensing	Sérigraphie	Dispensing	Sérigraphie	Sérigraphie	Sérigraphie
Propriété							
Sans halogènes		(+)		(+)		(+)	
Refusion sous azote (N ₂)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Refusion sous air	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Refusion phase vapeur	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)
Classification J-STD-004	L0	L0	L1		L0	H0	H1
Mouillabilité sous air	(+)		(+)		(+)	(+)	(+)
Mouillabilité sur Ni, sous air	(++)	(+)			(+)	(++)	
Résidus très clairs			(+)		(+)	n/a	n/a
Réduction des vides sous BGA			(+)		(+)		
Réduction des vides sur grande plages	(+)				(+)		(+)
Nettoyage facile à l'eau						(++)	(+)
Utilisation pour du Direct Copper Bonding		(+)				(+)	

GEL À BRASER

Flux	Sans Nettoyage				Nettoyage à l'eau		
	NC 5070	SF36	SF64	SURF 20	TF 38	TFD 54	WSD 3810-CFF
Nom							
Application(s)							
Réparation manuel, seringue	+	+	+		+	+	+
Réparation manuel, stylo				+			
Flip Chip, trempé (dipping)	+				+		
Propriété							
Sans halogènes	+	+	+	+	+		+
Pâte ou gel	+	+	+		+	+	+
Liquide				+			
Classification J-STD-004	L0	L0	L0	L0	L0	H1	H0
Couleur des résidus de flux	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Extrêmement transparent	n/a	n/a
Compatible avec Underfill i.e. : flip-chip/CSP sur PCB's					+		
Teneur en solides (%)	60	50	60	2.2	18	n/a	n/a
Mouillabilité	+	+	++		+	+	++
Pouvoir collant	++	+	+		+		++



CONDITIONNEMENT

Seringues